

High Tg & Mid Loss & Low CTE & Halogen Free
NY3170HF/NY3170HFP

特点 FEATURES:

- 低的介电常数和低介质损耗 Low dielectric constant and low dielectric loss
- 高TG无卤无铅兼容 High Tg halogen-free and lead-free compatible
- 低热膨胀系数及优异CAF可靠性 low thermal expansion coefficient and excellent CAF reliability

应用领域 APPLICATIONS:

- NOTEBOOK
- 服务器及AI设备 AI Server
- 基站 Base Station
- HDD/SSD
- Smart Phone/Wearable

基板典型性能 Typical Properties for NY3170HF Laminate

属 性 Property	项 目 Item		测 试 方 法 IPC-TM-650	测试条件 Test Condition	单位 Unit	典型值 Typical Value
热 性 能 Thermal	玻璃态转变温度 Tg		2.4.25	DSC	℃	190
			2.4.24	TMA	℃	/
			2.4.24.4	DMA	℃	/
	Z轴热膨胀系数 Z-axis Expansion		2.4.24	< Tg,TMA	PPM/℃	38
				> Tg,TMA	PPM/℃	185
			2.4.24	50~260℃	%	2.0
	热裂解温度 Td		2.4.24.6	TGA (5%W.L)	℃	385
	耐热性 T288		2.4.24.1	Clad	Min	>60
Etched				Min	>60	
电性能 Electrical	介电常数 DK (R/C:55%/70%)	1GHz	2.5.5.9	C-24/23/50	-	3.9/3.6
		10GHz	SPDR method			3.7/3.4
	介质损耗 Df (R/C:55%/70%)	1GHz	2.5.5.9		-	0.0084/0.0091
		10GHz	SPDR method			0.0095/0.0104
	体积电阻 Volume Resistivity		2.5.17.1	C-96/35/90	MΩ-cm	1.0×10 ¹⁰
	表面电阻 Surface Resistivity				MΩ	1.0×10 ¹⁰
物理性能 Physical	吸水率 Water Absorption		2.6.2.1	E-1/105+D-24/23	%	0.12
	剥离强度 Peel Strength (HTE)	Hoz	2.4.8	As Received	N/mm	0.9
	耐燃性 Flame Resistance		UL-94	A&E-4/125	-	V-0